



聯策科技—共創價值平台

SynPower — Co>Create to make better!

發言人:陳識翔 副總經理

電話:(03)369-0966

郵件:spokesman@synpower.com.tw



免 責 聲 明

- » 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務及業務狀況等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- » 本公司未來實際所可能產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、各種政策法令與金融經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- » 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於這些看法，未來若有變更或調整時，本公司並不負有更新或修正之責任。
- » 本簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。

大 綱

壹、公司簡介

貳、營運概況

叁、展望與策略

➤ 聯策－智能製造整合服務

壹、公司簡介

主要營運據點

◆ 台灣營運據點：桃園區

大陸營運據點：昆山、東莞、淮安、秦皇島

海外營運據點：泰國曼谷、印度清奈

貼近需求 就近服務



◆ 成立：2002年5月

◆ 資本額：3.29億

◆ 員工數：約300人

◆ 致力於電路板、半導體等產業之自動化設備、機器視覺應用業務。

➤ 子公司：

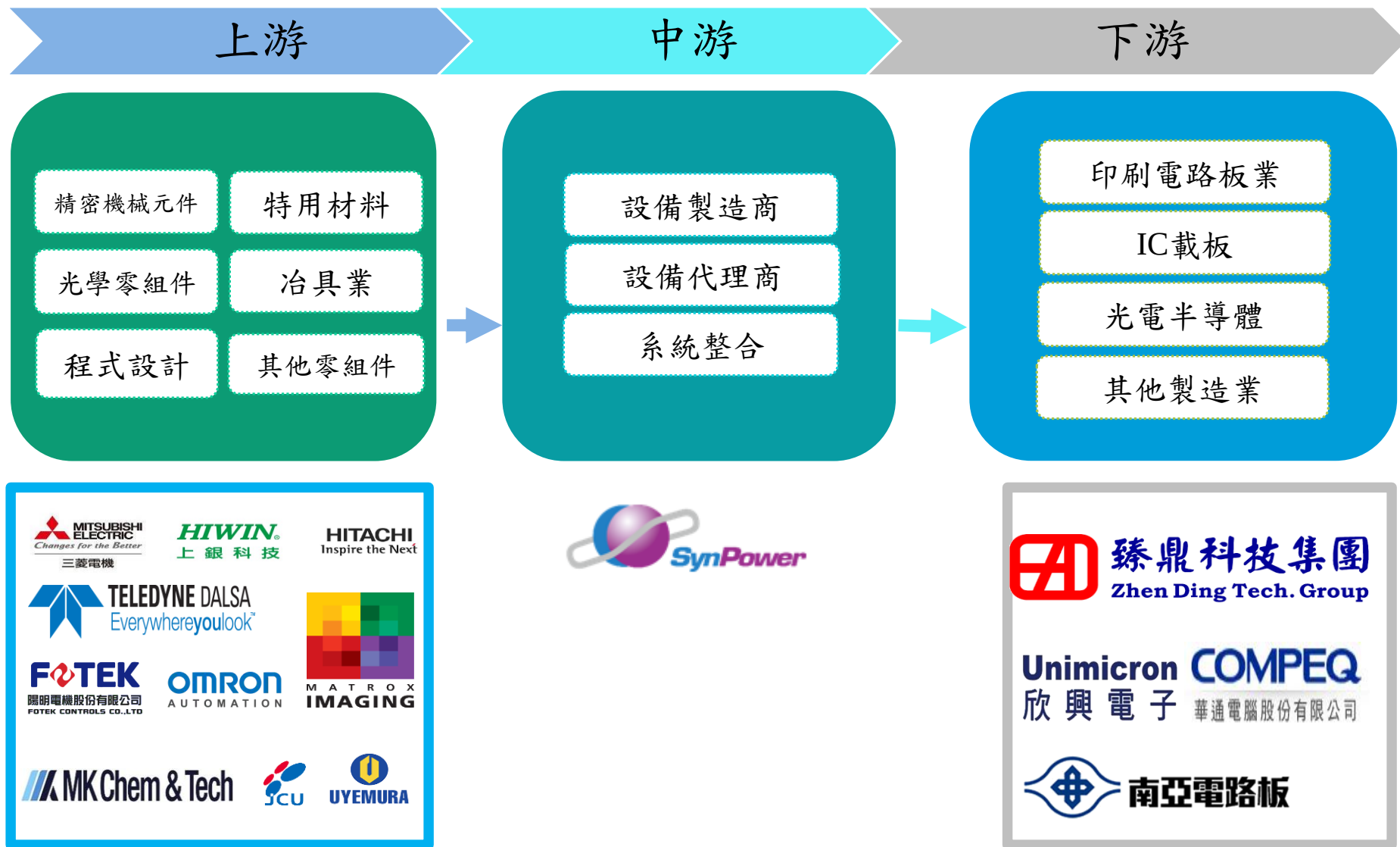
● 映利科技：各式水平濕製程設備

● 碩晶科技：PCB表面處理代工



▶ 產業地位 (產業上中下游之關聯性)

壹、公司簡介



新廠位置：新生路三段255巷

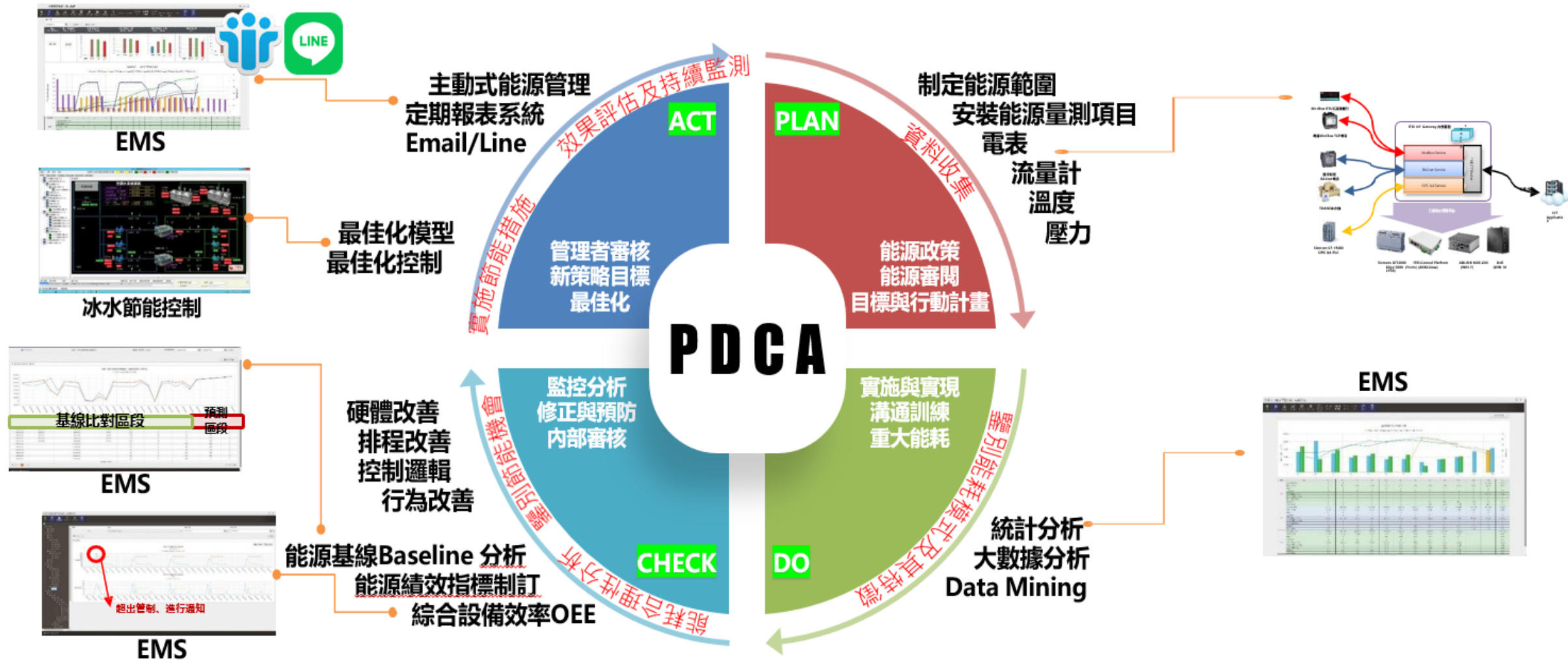
➤ 青埔新廠建置



- ◆ 預計2025/08啟用
- ◆ 坪數(含地下1F)：3,600坪
- ◆ 新廠外觀示意圖：



建置能源管理系統



➤ 企業社會責任

壹、公司簡介

路得學園 八德園遊會2024/3/23



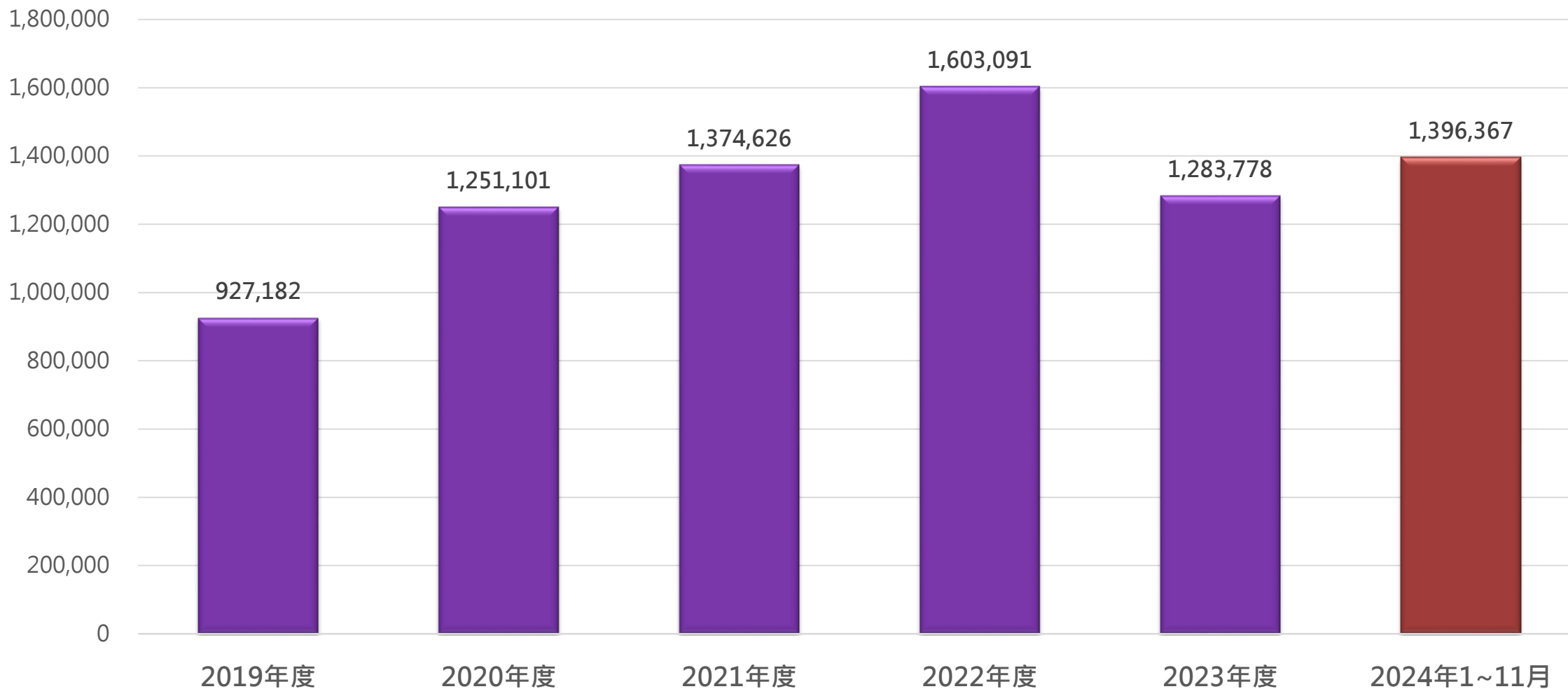
家扶基金會2023/11/11 遲緩兒 愛慢飛



2024/11 攜手募餐食、陪伴募得走三十



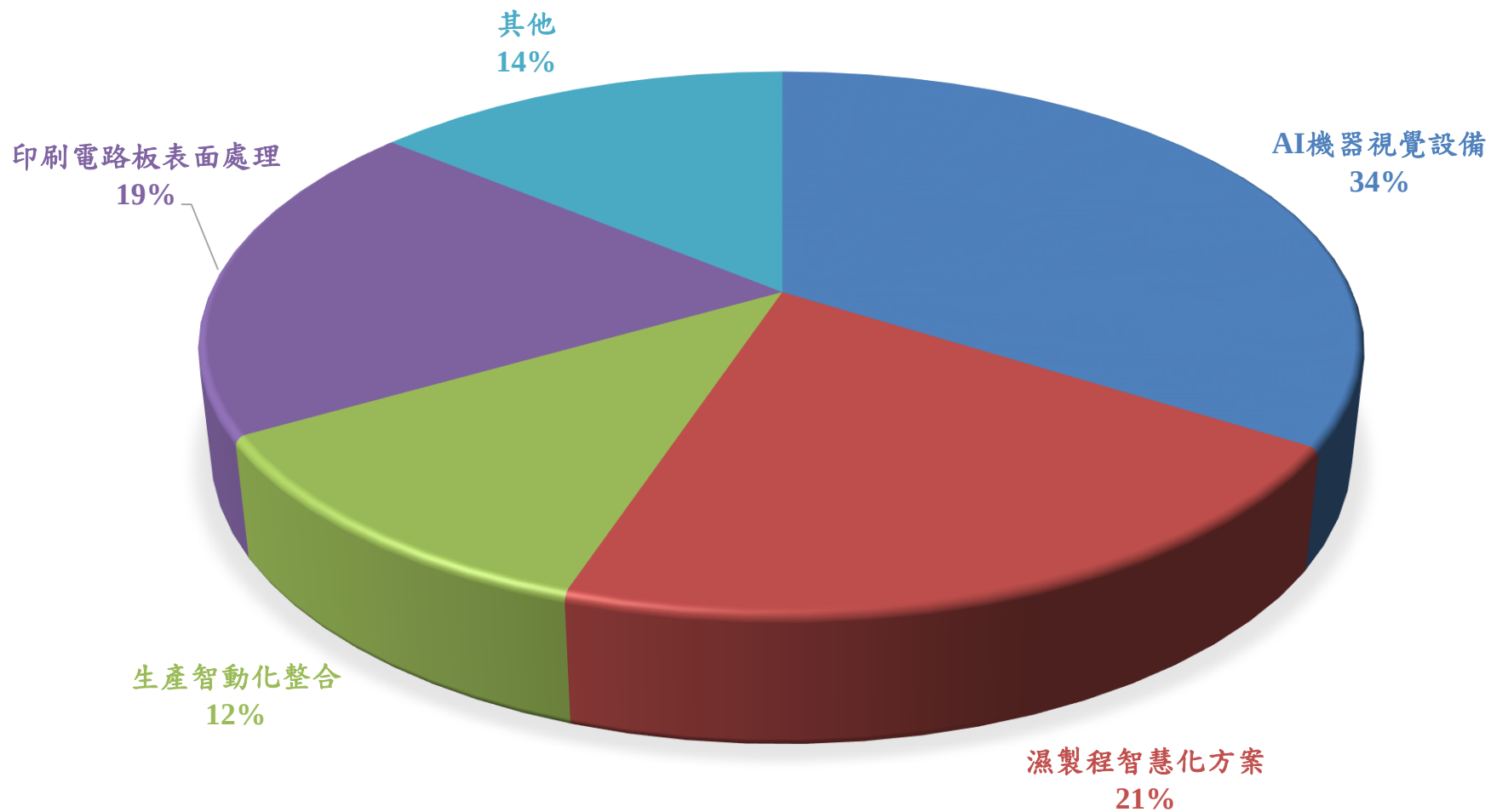
年度營收(新台幣仟元)



➤ 銷售實績-業績報告

貳、營運概況

2024年至11月主要銷售產品項目



➤股利政策

貳、營運概況

秉持穩定的股利政策，最近5年配息情形如下：

單位：新台幣元

年度		2019	2020	2021	2022	2023
股利政策	現金	1.2	0.6	1.2	2	1.2
	股票	-	1.2	-	-	-
合計		1.2	1.8	1.2	2	1.2

本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，股利發放以現金股利及股票股利平衡股利政策為主，其中**現金股利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利總額之百分之十**為限，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、因應景氣及產業變化情形等因素，並兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃，每年依法由董事會擬具盈餘分配案經股東會決議後分派之。

1. 聯策科技

01 設立泰國子公司並已取得光學檢量測與濕製程設備訂單

02 持續高階手機模組外觀檢測設備推廣

03 在線系統與節能減廢方案

04 AI降低檢測誤判與AI檢測邏輯應用於PCB以外之產業

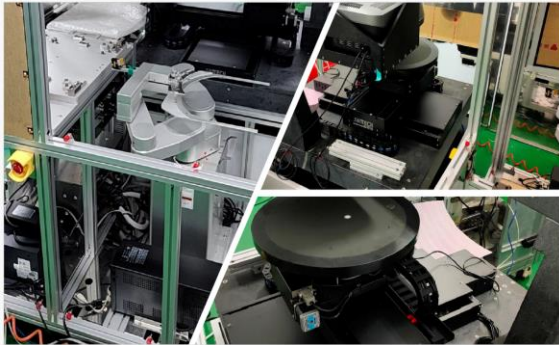
05 與日本合作最佳檢出能力的外檢機

06 準備半導體封測製程AOI自動化檢測開發計畫



日本基恩斯 (Keyence) 與聯策科技 (Synpower) 共同推出的自動化整合方案，係針對高良率要求且倚賴優異精密設備之半導體晶圓封測產業。

聯策科技的自動化整合方案，將每片的量測時間從人工量測的25分鐘大幅縮短至5分鐘，可將批量抽檢提升為全檢，提升槽化作業的良率達到減少後段製程的浪費。



2. 映利科技

泰國客戶新建廠濕製程設備訂單取得

節能風機已導入主要客戶並在其他廠域測試

玻璃基板電鍍Demo設備裝機中

整合材料與設備，提供TGV完整解決方案

玻璃基板TGV製程與設備



高深寬比雷射改質深蝕刻

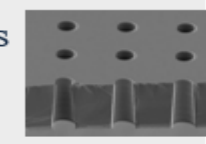
誠霸科技

加工速度

- 陣列孔：5000 孔/s
- 非陣列：200 孔/s

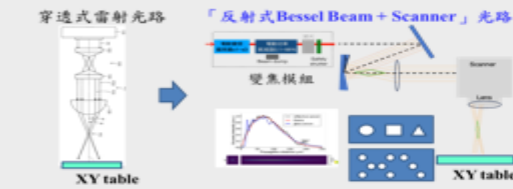
KOH蝕刻設備

- 孔徑均勻度>90%



穿透式雷射光路

「反射式Bessel Beam + Scanner」光路



XY table

微孔加工速度慢(10 孔/s)

微孔加工速度快(10~200 孔/s)

高深寬比玻璃附著層開發

聯策科技

- 附著層厚度：100~200nm
- 附著力： $\geq 5 \text{ N/cm}$
- 階梯覆蓋率： $\geq 65\%$
- 全濕式鍍膜設備



PVD Ti/Cu

低黏滯性複合TiOx溶液

成本高, AR<10

成本低, AR ≥ 20

高深寬比玻璃晶種層銅觸媒&高灌孔性化學銅液

超特科技

- 晶種層厚度： $\geq 250\text{nm}$
- 觸媒吸附量： $\leq 0.2 \text{ mg/dm}^2$
- 階梯覆蓋率： $\geq 70\%$
- 附著力：ASTM 5B @ 8吋
- 全濕式化鍍設備



鈀觸媒

銅觸媒

Substrate

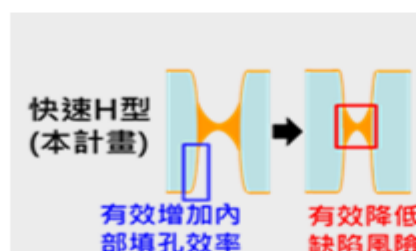
成本高, 後續線路製程需額外蝕刻

成本低, 線路製程不需額外蝕刻

高深寬比玻璃金屬化與填孔電鍍

聯策科技

- 填孔良率 $\geq 95\%$
- 架橋時間 ≤ 1 小時
- 面銅厚度： $\leq 15 \mu\text{m}$
- 全濕式高深寬比電鍍設備



TGV基板圖案化及可靠度驗證

立誠光電

- 附著層去除
- RDL線路製作
- 6項基板可靠度驗證測試



3. 頤晶科技

高頻應用的薄鍍製程代工線2025年開始接單

謝謝指導